

E

D

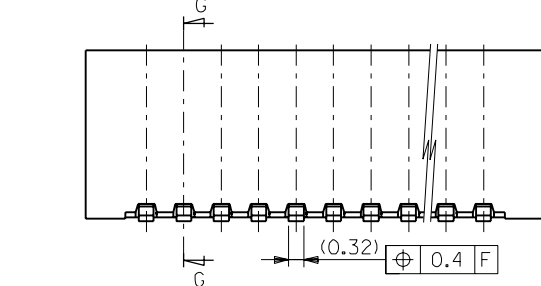
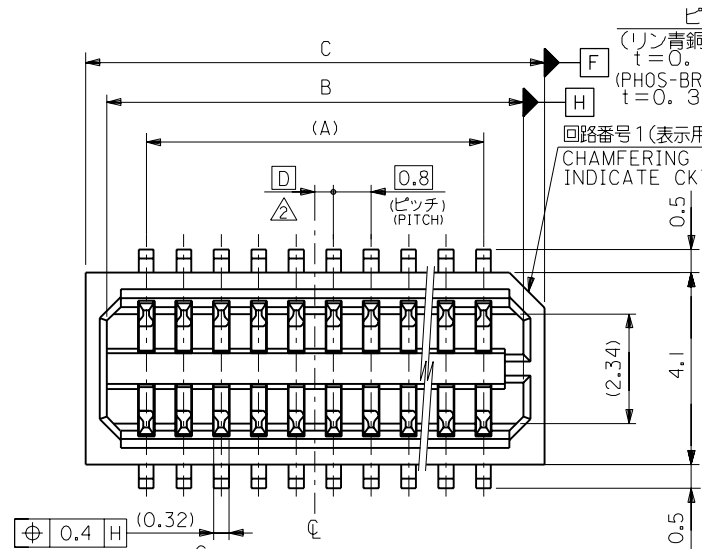
C

B

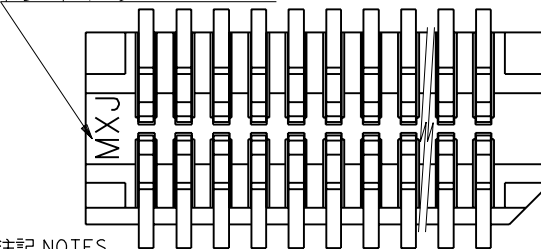
A

mm

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



トレードマーク TRADE MARK

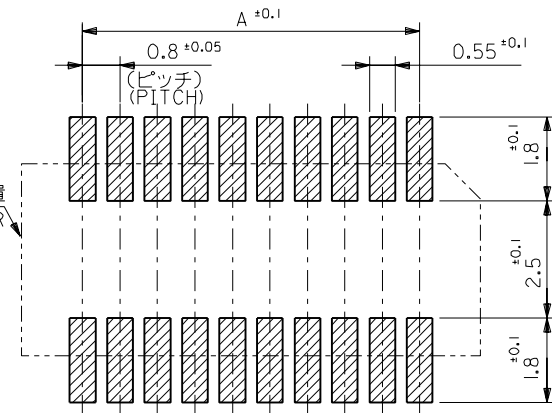
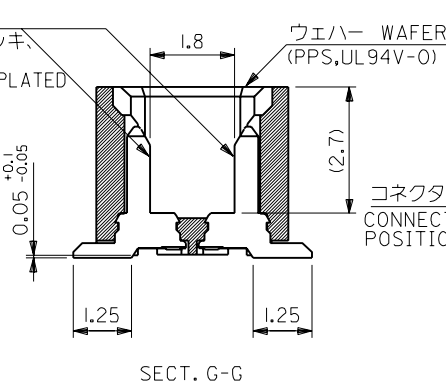


注記 NOTES

1. 嵌合相手: 52465,52588
MATE WITH: 52465,52588 SERIES

△ ウェハの 〇 から隣接するピンの 〇 迄の位置を示す。
SHOW POSITION FROM 〇 OF WAFER TO 〇 OF ADJACENT PINS.

角度 ANGLE	±3°				
30°以上 OVER	+0.3	B	変更 REVISED	JC70882	97/4/1
10°以上 30°未満 OVER UNDER	+0.25	A	変更 REVISED	JC60094	95/8/9
10°未満 UNDER	+0.2	O	新規作成 PROPOSED	(J11000)	97/11/16
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE



0.4	17.8	16.9	15.2	53307-4027	40
0.4	16.2	15.3	13.6	-3627	36
0.8	15.4	14.5	12.8	-3427	34
0.8	13.8	12.9	11.2	-3027	30
0.4	13.0	12.1	10.4	-2827	28
0.8	12.2	11.3	9.6	-2627	26
0.4	11.4	10.5	8.8	-2427	24
0.8	10.6	9.7	8.0	-2227	22
0.4	9.8	8.9	7.2	-2027	20
0.8	9.0	8.1	6.4	-1827	18
0.4	8.2	7.3	5.6	-1627	16
0.8	7.4	6.5	4.8	-1427	14
0.4	6.6	5.7	4.0	-1227	12
0.8	5.8	4.9	3.2	53307-1027	10
D	C	B	A	ENG. NO.	極数 CKT.

材料 MATERIAL	図中参照 SEE DRAWING
仕上げ FINISH	—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY '97/11/14 K.ASAKAWA	CHK'D BY '97/4/1 Y.MIZUNO
APP'D BY '97/4/1 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称
0.8 BOARD TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y ST. SMT (WITHOUT BOSS)
DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV SD-53307-**-27 B

DWG. NO. SD-53307-***27

E

D

C

B

A

mm DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8

7

6

5

4

3

2

1

F

E

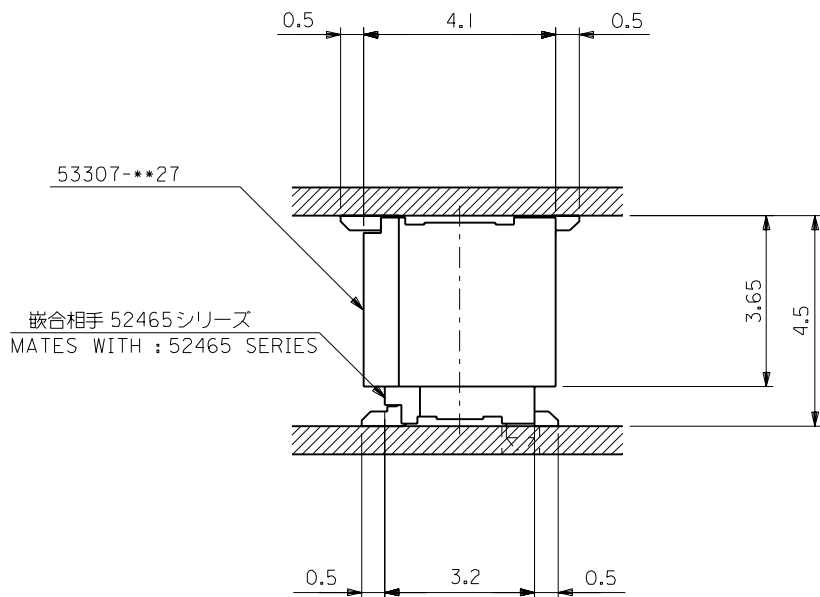
D

C

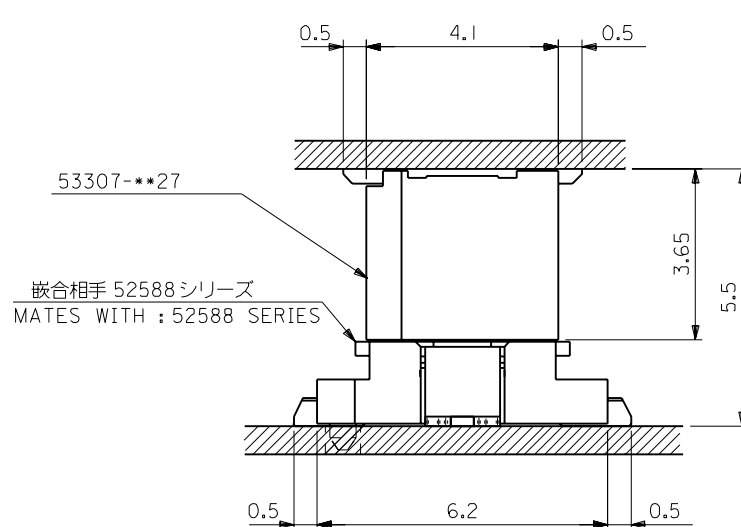
B

A

A53307.S10



嵌合状態図 (参考)
MATED DRAWING (REF.)



嵌合状態図 (参考)
MATED DRAWING (REF.)

角度	ANGLE	30°
30°以上	OVER	+0.3
10°以上 30°未満	OVER 30 UNDER	+0.25
10°未満	UNDER	+0.2
一般公差		
GENERAL TOLERANCES		

材料	MATERIAL	MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
SHEET 1 OF 2 参照	REFER TO SHEET 1 OF 2	日本モレックス株式会社
仕上げ	FINISH	—
適用電線範囲	WIRE RANGE	—
被覆外径	INS. RANGE	—
DRAWN BY '91/11/14	CHK'D BY '91/4/1	
K.ASAKAWA	Y.MIZUNO	
APP'D BY '91/4/1	尺 度	—
M.FUKUSHIMA	SCALE	—
記号	REVISION RECORD	
LTR	変更内容	
DR.	日付	
CHK.	DATE	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32

DWG. NO.
SD-53307-***9I

E

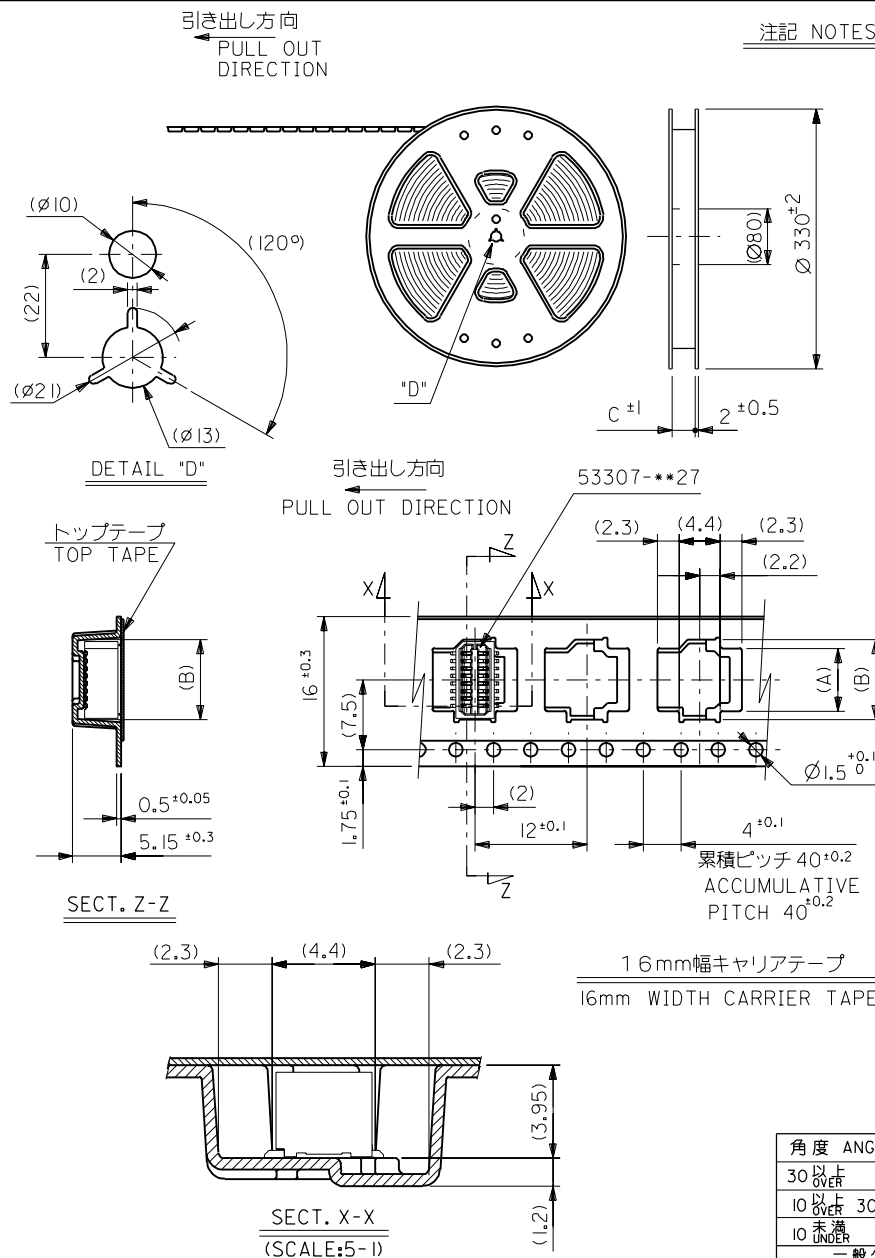
D

C

B

A

ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

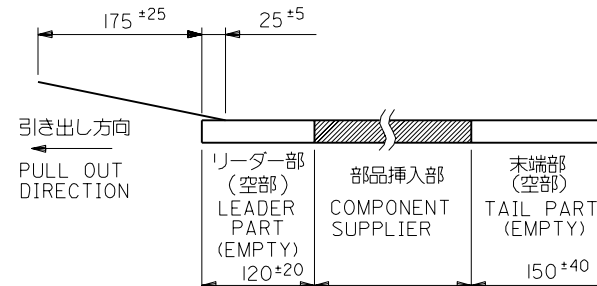


注記 NOTES

1. 梱包数量: 1000個/リール NUMBER OF CONNECTORS: 1000PCS/REEL
2. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

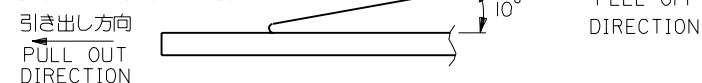
トッパテープ TOP TAPE
リーダー部 LEADER PART

トッパテープ TOP TAPE
未接着部 NON-BONDED PART



3. トッパテープの剥離強度: (剥離方向は下図参照)
0.1N~0.7N (10.2gf~71.4gf) 尚、本規格値は、出荷時に適用。
(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)

PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE
0.1N~0.7N (10.2gf~71.4gf) (PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED, DURING TRANSPORTATION



4. 材料

キャリアテープ: ポリプロピレン (PP)
トッパテープ: PET, PE, PEF
リール: ポリスチレン (PS)
<リサイクル材を含む>

MATERIAL
CARRIER TAPE: POLYPROPYLENE
TOP TAPE: PET, PE, PEF
REEL: POLYSTYRENE (PS)
<RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

16	17.5	9.3	7.5	53307-189I	18
		8.5	6.7	53307-169I	16
		7.7	5.9	53307-149I	14
		6.9	5.1	53307-129I	12
		6.1	4.3	53307-109I	10
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT

角度 ANGLE	30°以上 OVER 30	30°以下 UNDER 30
変更 REVISED	(JC2001-0479)	(JC70882)
新規/再考 PROPOSED	(J11065)	
一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD

材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH	—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY 91/11/22 K.ASAKAWA	CHK'D BY 00/12/20 T.ITO
APP'D BY 00/12/20 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE
日付 DATE	—

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称 0.8 B-To-B WAFER Assy SMT Embstp Pkg	
DWG. NO. (SHEET 1 OF 2)	REV
SD-53307-***9I	B

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-32

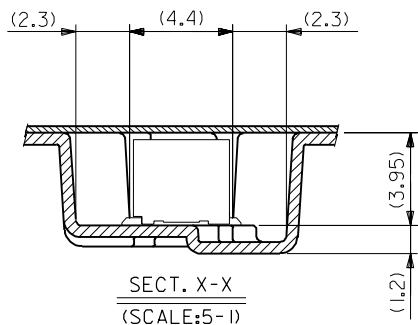
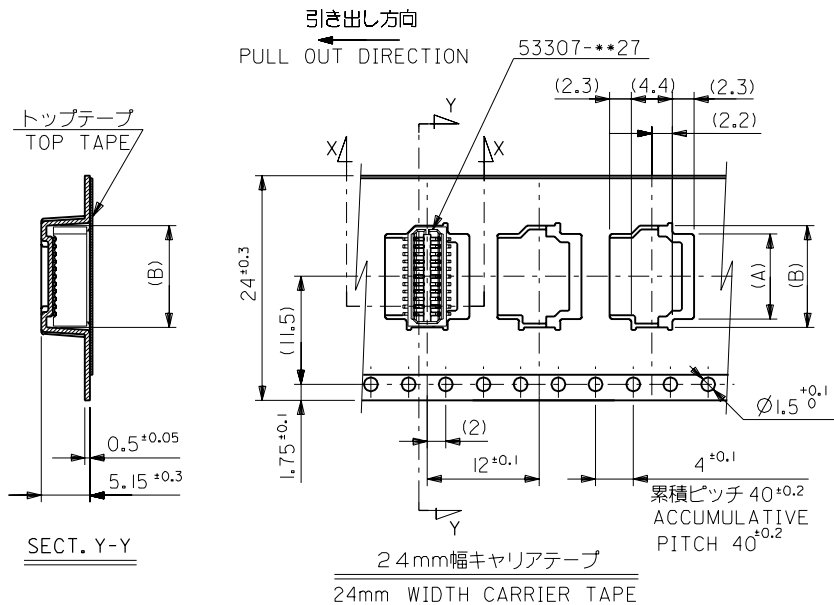
5949924A.S05

DWG. NO.
SD-53307-***91

E

D

C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



24	25.5	14.1	12.3	53307-3091	30
		13.3	11.5	53307-2891	28
		12.5	10.7	53307-2691	26
		11.7	9.9	53307-2491	24
		10.9	9.1	53307-2291	22
		10.1	8.3	53307-2091	20
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT

角度	ANGLE	3°	変更	REVISION	記号	変更内容	配号	変更内容	記号	変更内容
30°以上	OVER	+0.3	B	変更 (JC2001)	1.4	00/12/20	1.4	00/12/20	1.4	00/12/20
10°以上 30°未満	UNDER	+0.25	A	変更 (JC70882)	1.4	91/4/1	1.4	91/4/1	1.4	91/4/1
10°未満	UNDER	+0.2	O	新規作成 (J11065)	1.4	91/11/22	1.4	91/11/22	1.4	91/11/22
一般公差				記号	変更内容	配号	変更内容	記号	変更内容	配号
GENERAL TOLERANCES				LTR	REVISION RECORD	CHK.	DATE			

材料 MATERIAL		SHEET 1 OF 2参照 REFER TO SHEET 1 OF 2		モレックス株式会社 MOLEX-JAPAN CO.,LTD.	
仕上げ FINISH		適用電線範囲 WIRE RANGE		被覆外径 INS. RANGE	
DRAWN BY 91/11/22 K.ASAKAWA		CHK'D BY 00/12/20 T.ITO		DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV SD-53307-***91 B	
APP'D BY 00/12/20 M.FUKUSHIMA		尺度 SCALE		TITLE 名称 0.8 B-To-B WAFER Assy SMT Embstp Pkg	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32